PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-361744

(43)Date of publication of application: 18.12.2002

(51)Int.Cl.

H05K 3/00 B29L 7:00

B29L 9:00

(21)Application number: 2001-173943

(71)Applicant:

KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD

(22) Date of filing:

08.06.2001

(72)Inventor:

HASE NAOKI

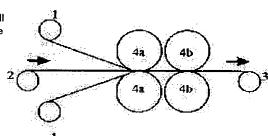
KATAOKA KOSUKE

FUSHIKI YASUO

54) METHOD FOR MANUFACTURING HEAT-RESISTANT FLEXIBLE LAMINATED SHEET

57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for preventing shrink marks from being generated when a heat-resistant adhesive film and a metal material are laminated over each other to obtain a flexible laminated sheet, and enhancing the productivity. SOLUTION: This method for manufacturing a heat-resistant flexible laminated sheet comprises he steps to laminate a metallic foil 1 and the heat-resistant adhesive film 2 over each other. using a heat roll laminating device with at least two or more pairs of metal rolls. The heating emperatures of the metal rolls are different from each other. That is, the heat-resistant adhesive film and the metal material are laminated (regularly laminated) by a first-stage metal roll hrough thermal pressurizing. Next, immediately after the regular lamination at the first stage, the aminate is annealed by a second-stage metal roll and the subsequent metal rolls at lower emperature than the regular laminating temperature. Finally the laminate is gradually cooled vhile being pressurized so as to reach a temperature near a glass transition temperature for the neat-resistant adhesive film.



EGAL STATUS

Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of ejection or application converted registration]

Date of final disposal for application]

Patent number

Date of registration]

Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-361744 (P2002-361744A)

(43)公開日 平成14年12月18日(2002.12.18)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
B 2 9 C	65/02		B 2 9 C	65/02	4 F 2 1 1
H05K	3/00		H05K	3/00	R
# B29L	7: 00		B 2 9 L	7: 00	
	9: 00			9: 00	

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特願2001-173943(P2001-173943)

(22) 出願日 平成13年6月8日(2001.6.8)

(71)出願人 000000941

鐘淵化学工業株式会社

大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

(72)発明者 長谷直樹

滋賀県大津市比叡辻2-5-8-105

(72)発明者 片岡孝介

滋賀県大津市坂本2-4-64

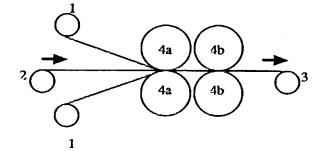
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 耐熱性フレキシブル積層板の製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】耐熱性接着フィルムと金属材料をラミネートしてフレキシブル積層板を作製する際のシワの発生を防ぎ、生産性を向上させる方法を提供する。

【解決手段】少なくとも2対以上の金属ロールを有する熱ロールラミネート装置を用いて金属箔1と耐熱性接着フィルム2を貼り合わせて耐熱性フレキシブル積層板を作製する製造方法であって、該金属ロールの加熱温度がそれぞれ異なるものとする。すなわち、1段目の金属ロールによって、耐熱性接着フィルムと金属材料が加熱・加圧されてラミネート(本ラミネート)される。そして、1段目の本ラミネート直後に本ラミネート温度より低い温度である2段目以降の金属ロールによって徐冷ラミネートを行い、最終的に耐熱性接着フィルムのガラス転移温度付近の温度まで加圧しながら徐々に冷却していく。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも2対以上の金属ロールを有する熱ロールラミネート装置を用いて金属材料と耐熱性接着フィルムを貼り合わせて耐熱性フレキシブル積層板を作製する製造方法であって、該金属ロールの加熱温度がそれぞれ異なることを特徴とする耐熱性フレキシブル積層板の製造方法。

【請求項2】 前記熱ロールラミネート装置の各金属ロールの加熱温度が50℃以上異なることを特徴とする請求項1に記載の耐熱性フレキシブル積層板の製造方法。

【請求項3】 前記熱ロールラミネート装置の最後段の 金属ロールの加熱温度が(耐熱性接着フィルムのガラス 転移温度+30℃)以下であることを特徴とする請求項 1乃至請求項2のいずれか1項に記載する耐熱性フレキ シブル積層板の製造方法。

【請求項4】 前記熱ロールラミネート装置の2対以上の金属ロールの直径が異なることを特徴とする請求項1 乃至請求項3のいずれか1項に記載する耐熱性フレキシブル積層板の製造方法。

【請求項5】 前記熱ロールラミネート装置を用いて金属箔と耐熱性接着フィルムを張り合わせる際に、該装置の加圧面と被積層材料との間に保護材料を配置することを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載する耐熱性フレキシブル積層板の製造方法。

【請求項6】前記熱ロールラミネート装置の第1段の金属ロールによる加圧加熱成形が200℃以上で行われ、かつ、保護材料と被積層材料とを軽く密着させておき、冷却後に該保護材料を積層板から剥離することを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載する耐熱性フレキシブル積層板の製造方法。

【請求項7】 前記耐熱性接着フィルムとして、接着成分中に熱可塑性ポリイミドを50重量%以上含有する接着シートを用いることを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載する耐熱性フレキシブル積層板の製造方法。

【請求項8】 前記金属材料として、厚みが50μm以下の銅箔を用いることを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載する積層板の製造方法。

【請求項9】 前記保護材料として、ポリイミドフィルムを用いることを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載する積層板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、加圧加熱成形装置で製造される積層板の製造方法に関する。特には、電子電気機器等に用いられるフレキシブル積層板の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、エレクトロニクス製品の軽量化、 小型化、高密度化に伴い、プリント基板の需要が高くな

り、特に、絶縁性フィルム上に銅箔回路を形成して成る フレキシブルプリント基板の需要が高まっている。この フレキシブル積層板には、金属箔が熱硬化性樹脂等の熱 硬化型接着剤によって貼付された積層板(以下、熱硬化 型の積層板と表す)と、熱可塑性樹脂等の熱融着型接着 剤によって貼付された積層板(以下、熱融着型の積層板 と表す)がある。熱硬化型の積層板は、ポリイミドフィ ルム等の耐熱性フィルムの両面にエポキシ樹脂やアクリ ル樹脂といった熱硬化型の接着剤を形成し、金属箔と貼 り合わせた後、長時間キュアを行い、硬化を完了させ作 製される。近年、環境問題から半田材料に従来の融点よ り高温である鉛フリーの半田が用いられるようになり、 それに伴い、フレキシブル積層板に要求される耐熱性が さらに厳しいものとなり、この接着層のエポキシ樹脂、 アクリル樹脂では耐熱性を満足することができなくなっ てきた。

【0003】その耐熱性の要求に応えるべく、接着層に熱可塑性ポリイミド樹脂を使用した熱融着型の積層板が使用されている。熱融着型の積層板の製造は、金属材料の片面にポリイミド樹脂を塗布・乾燥、もしくはポリイミド前駆体溶液を塗布・乾燥・キュアし、接着面同士を向かい合わせにした状態でラミネート装置で貼り合わせて両面のフレキシブル積層板を製造する方法や、ポリイミドフィルム等の耐熱性フィルムの両面にポリイミド樹脂を塗布・乾燥、もしくはポリイミド前駆体溶液を塗布・乾燥・キュアして接着フィルムを作製し、銅箔/接着フィルム/銅箔の構成で、ラミネート装置で貼り合わせて両面のフレキシブル積層板を製造する方法等がある。【0004】

【発明が解決しようとする課題】上記した熱硬化型の積層板を製造する場合、加圧加熱成形温度は200℃以下である場合が殆どである。この程度の加熱温度では、被積層材料にかかる熱応力が小さく、熱ラミネート時のシワ等の外観不良は発生しにくい。

【0005】ところが、熱融着型の積層板を製造する場合、接着層を構成する熱可塑性樹脂のガラス転移温度(Tgと表す)以上の温度で加圧加熱を行わなければ熱融着ができない。一方、電子電気機器用積層板は、部品実装の過程で高温加熱を受けるので、接着層を構成する熱可塑性樹脂には少なくとも180℃以上のTgが求められる。更にその熱融着のためには200℃以上の熱ラミネート温度が必要となる。この様な高温でのラミネートでは、被積層材料の熱膨張・熱収縮の変化が大きくなり、ラミネートされた積層体にシワ等の外観不良を生じやすいという問題がある。

【0006】シワの発生原因をより詳しく説明すると、 熱ロールラミネート機で銅箔と熱可塑性ポリイミドをラ ミネートする場合、熱ロールラミネート機の加熱加圧状 態のプレスロール間を通過することで、銅箔と熱可塑性 ポリイミドが貼り合わされる。ラミネート時、各被積層 材料は熱によって膨張した状態にあるが、一般に銅箔の 線膨張係数よりも熱可塑性ポリイミドの線膨張係数は大 きいため、銅箔より面方向に大きく伸びた状態で熱可塑 性ポリイミドは銅箔と熱ラミネートされる。そして、圧 力が開放されるラミネート直後も、材料が熱を保持して おり、その温度が熱可塑性ポリイミドのTgよりも高い ために熱可塑性ポリイミドは流動状態にあり、これが急 激に冷却されることによって熱可塑性ポリイミドは銅箔 より面方向に大きく縮め、できた積層板は面方向にシワ を生じる。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は前記問題点に鑑み、耐熱性接着フィルムと金属材料をラミネートしてフレキシブル積層板を作製する際のシワの発生を防ぎ、生産性を向上させる方法を提供するものである。

【0008】すなわち、本発明者らは、熱ロールラミネ ート装置の前段の金属ロールの後段に前段の金属ロール より加熱温度の低い金属ロールを追加して、連続してラ ミネートを行うことによって、フレキシブル積層板にで きるシワを低減できることを見出したのである。詳しく **言うと、1段目の金属ロール(本ラミネートロールとも** いう)によって、耐熱性接着フィルムと金属材料が加熱 ・加圧されてラミネートされる。そのとき、ラミネート ロールの加熱によって、耐熱性接着フィルムと金属材料 は伸ばされた状態で貼り合わされる。それぞれの材料は 線膨張係数が異なるため、常温の時からの伸び量が異な り、その状態で貼り合わせられるため、急激に常温に戻 ったときに耐熱性接着フィルムと金属材料の縮み量の違 いからできたフレキシブル積層板にシワを生じる。この とき、1段目の本ラミネート直後に本ラミネート温度よ り低い温度である 2段目以降の金属ロールによって徐冷 ラミネート(以下2段目以降の金属ロールを徐冷ラミネ ートロールともいう)を行い、最終的に耐熱性接着フィ ルムのTg付近の温度まで加圧しながら徐々に冷却して いくことで、フレキシブル積層板にシワを生じないこと を見出したのである。

【0009】従って、本発明の請求項1は、少なくとも2対以上の金属ロールを有する熱ロールラミネート装置を用いて金属箔と耐熱性接着フィルムを貼り合わせて耐熱性フレキシブル積層板を作製する製造方法であって、該金属ロールの加熱温度がそれぞれ異なることを特徴とする耐熱性フレキシブル積層板の製造方法である。請求項2は、各金属ロールの加熱温度が50℃以上異なることを特徴とする請求項1に記載の耐熱性フレキシブル積層板の製造方法である。請求項3は、前記熱ロールラミネート装置の最後段の金属ロールの加熱温度が(耐熱性接着フィルムのガラス転移温度+30℃)以下であることを特徴とする請求項1乃至請求項2のいずれか1項に記載する耐熱性フレキシブル積層板の製造方法である。請求項4は、前記熱ロールラミネート装置の2対以上の

金属ロールの直径が異なることを特徴とする請求項1万 至請求項3のいずれか1項に記載する耐熱性フレキシブ ル積層板の製造方法である。請求項5は、前記熱ロール ラミネート装置を用いて金属箔と耐熱性接着フィルムを 張り合わせる際に、該装置の加圧面と被積層材料との間 に保護材料を配置することを特徴とする請求項乃至請求 項4に記載する耐熱性フレキシブル積層板の製造方法で ある。請求項6は、前記熱ロールラミネート装置の第1 段の金属ロールによる加圧加熱成形が200℃以上で行 われ、かつ保護材料と被積層材料とのを軽く密着させて おき、冷却後に該保護材料を積層板から剥離することを 特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載 する耐熱性フレキシブル積層板の製造方法である。ここ で、保護材料とは積層板の非構成材料をさす。また、保 護材料と被積層材料はラミネートロールを通過すること で軽く密着された状態にある。ここで軽く密着という状 態は、保護フィルムと被積層材料が何も力を加えない状 態で双方が剥離しない状態をいい、手で剥がすと簡単に 剥がれる状態をいう。

【0010】請求項6は、前記耐熱性接着フィルムとして、接着成分中に熱可塑性ポリイミドを50重量%以上含有する接着シートを用いることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載する耐熱性フレキシブル積層板の製造方法である。請求項7は、前記金属材料として、厚みが50μm以下の銅箔を用いることを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載する積層板の製造方法である。請求項8は、前記保護材料として、ポリイミドフィルムを用いることを特徴とする請求項1乃至請求項7のいずれか1項に記載する積層板の製造方法である。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の詳細について説明 する。

【0012】本発明の製造方法で得られる積層板の用途 は特に限定されるものではないが、主として電子電気用 のフレキシブル積層板として用いられるものである。

【0013】耐熱性接着フィルムとしては、熱融着性を有する樹脂から成る単層フィルム、熱融着性を有さないコア層の両側に熱融着性を有する樹脂層を形成して成る複数層フィルム、紙、ガラスクロス等の基材に熱融着性を有する樹脂を含浸したフィルム等が挙げられるが、ガラスクロス等の剛性のある基材を使用すると屈曲性が劣ることより、フレキシブル積層板用の接着フィルムとしては、熱融着性を有する樹脂から成る単層フィルム、熱融着性を有する樹脂から成る単層フィルムが好ましい。熱融着性を有する樹脂から成る単層フィルムが好ましい。熱融着性を有する樹脂の大変になる複数層フィルムとしては耐熱性を有する樹脂層を形成して成る複数層フィルムとしては耐熱性を有する樹脂層を形成して成る複数層フィルムとしては耐熱性を有する樹脂層などの接着フィルム中の熱融着性を有する樹脂層などの接

着成分が熱可塑性ポリイミド系成分から成るもの、例えば、熱可塑性ポリイミド、熱可塑性ポリアミドイミド、熱可塑性ポリエステルイミド等が好適に用いられ得る。これらの耐熱性の熱可塑性樹脂を接着成分中の50%以上含有する接着フィルムも本発明には好ましく用いられ、エポキシ樹脂やアクリル樹脂のような熱硬化性樹脂等を配合した接着フィルムの使用も好ましい。各種特性の向上のために接着フィルムには種々の添加剤が配合されていても構わない。例えば、フィルムの表面滑り性改善のためであれば、フィラー等の充填剤が使用でき、特にその種類は限定しないが、リン酸水素カルシウム等のフィラーを使用することができる。

【0014】接着フィルムの構成は、耐熱性の接着層を外側に有するものであれば、熱融着性の接着成分のみから成る単層でも構わないが、寸法特性等の観点から、熱融着性を有さないコア層の両側に熱融着性の接着層を有する3層構造のフィルムが好ましい。この熱融着性を有さないコア層は、耐熱性があれば特に限定しないが、非熱可塑性のポリイミドフィルムの使用が好ましい。

【0015】接着フィルムの作製方法については特に限 定しないが、接着剤層単層からなる場合、ベルトキャス ト法、押出法等により製膜することができる。また、接 着フィルムの構成が接着層/熱融着性を有さないコア層 /接着層という3層からなる場合、熱融着性を有さない コア層 (例えば、耐熱性フィルム)の両面に接着剤を、 片面ずつ、もしくは両面同時に塗布して3層の接着シー トを作製する方法や、耐熱性フィルムの両面に接着成分 のみからなる単層の接着フィルムを配して貼り合わせて 3層の接着フィルムを作製する方法がある。接着剤を塗 布して3層の接着フィルムを作製する方法において、特 にポリイミド系の接着剤を使用する場合、ポリアミック 酸の状態で耐熱性フィルムに塗布し、次いで乾燥させな がらイミド化を行う方法と、そのまま可溶性ポリイミド 樹脂を塗布し、乾燥させる方法があり、接着剤層を形成 する方法は特に問わない。その他に、接着層/耐熱融着 性を有さないコア層/接着層のそれぞれの樹脂を共押出 して、一度に耐熱性接着フィルムを製膜する方法もあ る。

【0016】金属材料としては、特に限定しないが、電子電気機器用に用いられる積層板の場合、導電性・コストの点から銅箔を用いるのが好ましい。また、金属箔の厚みについては、銅箔の厚みが薄いほど回路パターンの線幅を細線化できることから、50μm以下の銅箔が好ましい。特に35μm以下の銅箔はそれ以上の厚みの銅箔に比べてコシがなく、熱ラミネートする際にシワを生じやすいため、35μm以下の銅箔について、本発明は顕著な効果を発揮する。また、銅箔の種類としては圧延銅箔、電解銅箔、HTE銅箔等が挙げられ特に制限はなく、これらの表面に接着剤が塗布されていても構わな

LI.

【0017】 熱ロールラミネート装置については、被積 層材料を加熱して圧力を加えてラミネートする装置であ れば特にこだわらない。加熱方法について、所定の温度 で加熱することができるものであれば特にこだわらず、 熱媒循環方式、熱風加熱方式、誘電加熱方式等が挙げら れる。加熱温度は200℃以上が好ましいが、電子部品 実装のために積層板が雰囲気温度240℃の半田リフロ 一炉を通過する用途に供される場合には、それに応じた Tgを有する熱融着シートを使用するため240℃以上 の加熱が好ましい。本発明においては少なくとも2対以 上の金属ロールを用いるが、必要に応じてゴムなどの金 属ロール以外の材質のラミネートロールを用いてもよ い。 加圧方式についても所定の圧力を加えることがで きるものであれば特にこだわらず、油圧方式、空気圧方 式、ギャップ間圧力方式等が挙げられ、圧力は特に限定 されない。

【0018】ラミネートロールの構成は、2対以上が好 ましく、それぞれの1対1対のラミネートロールの加熱 温度を徐々に下げていって、ラミネートされたフレキシ ブル積層板を徐々に冷却していくのが好ましい。詳しく 言えば、1段目の本ラミネートロールにおいて、耐熱性 接着フィルムのTg以上の温度で、加圧・加熱しえ金属 材料と融着させ、続いて2段目の徐冷ラミネートロール は本ラミネートロールより低い温度で加圧・加熱し、3 段目の徐冷ラミネートロールは2段目の徐冷ラミネート ロールより低い温度で加圧・加熱し、最後段の徐冷ラミ ネートロールの温度は耐熱性接着フィルムの流動状態か ら固定するために(耐熱性接着フィルムのTg+30 ℃) 以下であることが好ましい。最後段の徐冷ラミネー トロールの温度がそれ以上であると、耐熱性接着フィル ムの接着成分がまだ流動状態であるため、できたフレキ シブル積層板に微小なシワを生じてしまう。本ラミネー トロール、徐冷ラミネートロールの温度差は何度であっ ても構わないが、数℃差であると本ラミネートから耐熱 性接着フィルムのTg+30℃まで、数十段のラミネー トロールを必要することとなり、設備的にもコストがか かるものとなる。実用的には、本ラミネートロール、徐 冷ラミネートロールの温度差は50℃以上であることが 好ましく、コストの面でそのラミネートロールの段数も 2~5段が好ましい。

【0019】また、徐冷ラミネートでは、加圧しながら徐冷ラミネートロールを通過させることが重要である。加圧しながら徐冷することによって、シワの発生をより防ぐことができる。 このときの圧力は、15N/mm~75N/mmが好ましい。ラミネートロールの直径は特にこだわらず、隣接するラミネートロールの直径も特にこだわらないが、直径が異なるほうがより近接に設置できるので好ましい。

【0020】保護材料は使用しなくても構わないが、さ

らにラミネートした製品のシワ発生等を抑制する目的で 使用しても構わない。保護材料を使用する場合は、ラミ ネートした製品のシワ発生等の外観不良から保護するこ とを満たすものであれば何でも良い。ただし、加工時の 温度に耐え得るものでなければならず、例えば250℃ で加工する場合は、それ以上の耐熱性を有するポリイミ ドフィルム等が有効である。保護材料の厚みは特に限定 しないが、ラミネート後の積層板のシワ形成を抑制する 目的から、50μm以上の厚みが好ましい。保護材料の 厚みが75μm以上であればシワ形成をほぼ完全に抑制 できるため、さらに好ましい。また、保護材料は被積層 材料と軽く密着するものであれば、特に表面処理等を施 す必要がない。逆に保護材料が被積層材料と密着しない ものである場合、保護材料側に軽く密着するような表面 処理を施したり、銅箔側に同様な表面処理を施したり、 保護材料、銅箔の両方に表面処理を施したりしても構わ ない。また、銅箔表面の酸化を防ぐ目的で施された防錆 処理等、他の目的で施した表面処理であっても、保護材 料と被積層材料が軽く密着するようなものであれば、表 面処理を施してあっても構わない。

【0021】保護材料を剥離する際の積層板の温度は、熱可塑性樹脂を被積層材料として使用する場合には、そのTg以下の温度が好ましい。より好ましくはTgよりも50℃以上低い温度、更に好ましくはTgよりも100℃以上低い温度である。最も好ましくは室温まで冷却された時点で保護材料を積層板から剥離するのが好ましい。以下実施例を記載して本発明をより詳細に説明す

る。

[0022]

【実施例】本発明の実施例及び比較例を挙げ、本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものでない。以下、実施例、比較例において、接着剤層の物性およびフレキシブル基板の物性は次のようにして測定した。剥離強度は、JIS C6471「6.5引きはがし強さ」に従い、サンプルを作製し、180度の剥離角度で5mm幅の銅箔部分を50mm/minの条件で剥離し、その荷重を測定した。フレキシブル積層板の外観状態は、目視にて以下の基準により判定した。

◎・・シワが全くない

〇・・1 m²あたりにシワが1個以下

 \bigcirc $\triangle \cdot 1 \, \text{m}^2$ あたりにシワが3個以下

 $\triangle \cdot \cdot 1$ m²あたりにシワが5個以下

×・・1 m²あたりにシワが5個以上

(実施例1~11)耐熱性接着フィルム(鐘淵化学工業製の25μm厚PIXED BP HT-142、Tg190℃の両側に金属材料(ジャパンエナジー製の18μm圧延銅箔BH Y-22B-T)を配した状態で、図1~図11のような熱ロールラミネート装置で、表1に示すラミ温度、ラミ圧力50N/mm、ラミ速度2.0m/minの条件でラミネートを行い、フレキシブル積層板を得た。その結果、外観にシワなく、剥離強度の問題ないフレキシブル積層板を得た。詳細は表1に示す。

[0023]

【表1】

		実施例	実施例	実施例	実施例	実施術	実施例	実施例	実施例	実施例	吳施例	実施例
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ラミネート装置		図1	图2	図3	⊠4	図5	図6	図7	図8	図 9	図10	図11
ラミネート	4a	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
ロール温度	4b	200	200	250	250	250	300	300	300	310	300	300
(°C)	4c			200	200	200	250	250	250	270	250	250
	4d	_		-		_	200	200	200	230	200	200
	4e		-	_	_		_	-	_	200	150	150
保護フィノ	保護フィルム		なし	なし								
フレキシブル積層板の		Δ	Δ	ΔΟ	ΟΔ	ΟΔ	0	C	0	0	0	Ö
外観状態												
剥離強度(N/cm)		12	12	12	12_	12	12	12	12	12	12	12

(実施例12~14)耐熱性接着フィルム(鐘淵化学工業製の25μm厚PIXEO BP HT-142、Tg190度)の両側に金属材料(ジャパンエナジー製の18μm圧延銅箔BHY-22B-T)を配し、さらにその両側に保護材料(鐘淵化学工業製のアピカル125AH)を配した状態で、図12~図14のような熱ロールラミネート装置で、表1に示すラミ温度、ラミ圧力50N/mm、ラミ速度2.0m/minの条件でラミネートを行い、フレキシブル積層板を得た。その結果、外観にシワなく、剥離強度の問題ないフ

レキシブル積層板を得た。詳細は表2に示す。

(比較例1、2) 実施例1と同様な材料を用いて、図15のような熱ロールラミネート装置で、表1に示すラミ温度、ラミ圧力50N/mm、ラミ速度2.0m/minの条件でラミネートを行い、フレキシブル積層板を得た。その結果、剥離強度は問題なかったが、ラミネート進行方向にシワが発生した。詳細は表2に示す。

[0024]

【表2】

	·	実施例 1 2	実施例 13	実施例 14	比較例 1
ラミネート装置		图12	⊠ 13	図14	⊠15
ラミネート	4a	350	350	350	350
ロール温度	4b	200	200	250	-
(°C)	4c	-	_	200	±
	4d	1		_	_
	4e	_	-	_	-
保護フィルム		あり	あり	あり	なし
フレキシブル独層板の 外観状態		ΟΔ	0	0	×
剥離強度(N/cm)		12	12	12	12

[0025]

【発明の効果】本発明によって、熱ロールラミネート装置でのフレキシブル積層板の生産性を格段に向上させることができる。従って本発明は、特に電子電気機器用のフレキシブル積層板として好適な材料を提供するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】2対のラミネートロールを有するの熱ロールラミネート装置

【図2】2対のラミネートロールを有するの熱ロールラミネート装置

【図3】3対のラミネートロールを有するの熱ロールラミネート装置

【図4】3対のラミネートロールを有するの熱ロールラミネート装置

【図5】3対のラミネートロールを有するの熱ロールラミネート装置

【図6】4対のラミネートロールを有するの熱ロールラミネート装置

【図7】4対のラミネートロールを有するの熱ロールラミネート装置

【図8】4対のラミネートロールを有するの熱ロールラ

ミネート装置

【図9】5対のラミネートロールを有するの熱ロールラミネート装置

【図10】5対のラミネートロールを有するの熱ロール ラミネート装置

【図11】5対のラミネートロールを有するの熱ロールラミネート装置

【図12】2対のラミネートロールを有するの熱ロール ラミネート装置

【図13】2対のラミネートロールを有するの熱ロール ラミネート装置

【図14】3対のラミネートロールを有するの熱ロール ラミネート装置

【図15】1対のラミネートロールを有するの熱ロール ラミネート装置

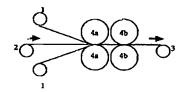
【符号の説明】

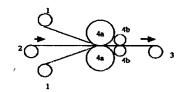
- 1 金属材料
- 2 接着フィルム
- 3 製品巻取装置
- 4a~4e ラミネートロール
- 5 保護フィルム
- 6 保護フィルム巻取装置

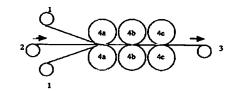
【図1】

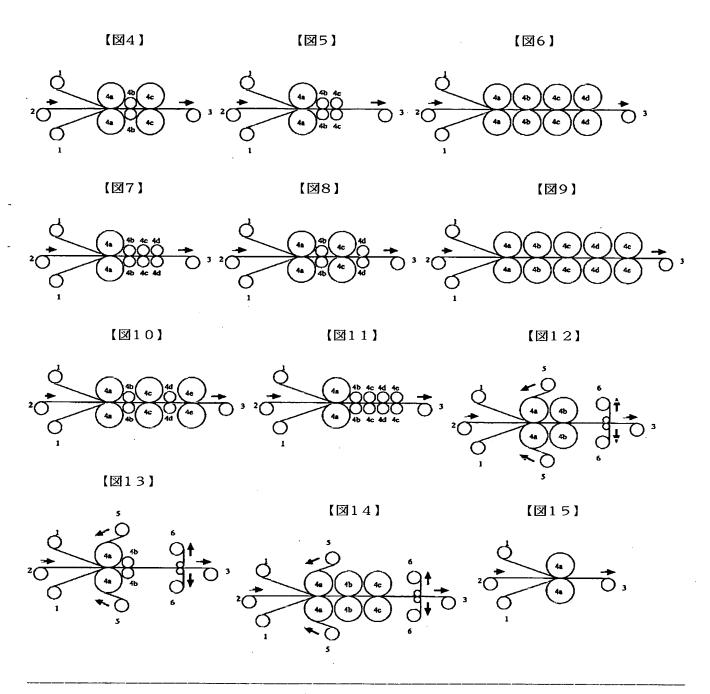
【図2】

【図3】









フロントページの続き

(72)発明者 伏木八洲男

京都府山科区音羽前出町33-1-702

F ターム(参考) 4F211 AA40 AD03 AD08 AG01 AG03 AH36 AR06 TA03 TC02 TD11 TJ30 TN09 TN44 TN52 TN53 TN56 TN58